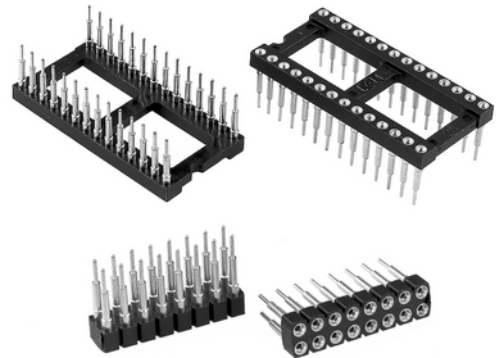


IC-Fassung / IC-Leiste - Bauhöhe 6mm ... 15mm IC Sockets / IC-Strips - Height 6,0mm ... 15,0mm

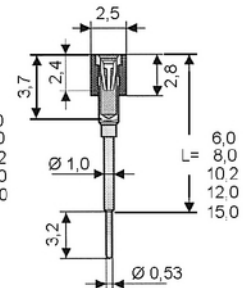
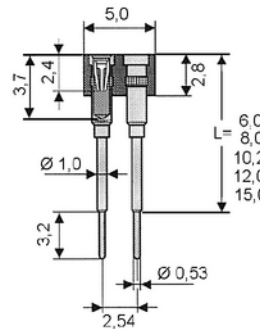
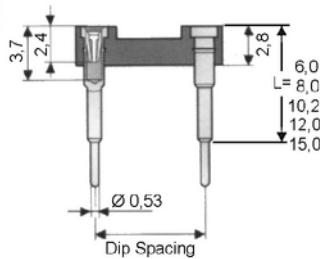
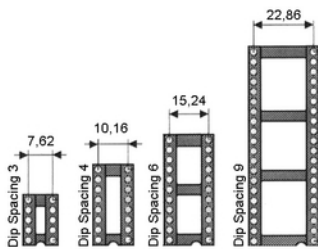
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined brass Clip: 4 Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ¹⁰ Ω
Insulation Resistance	> 10 ¹⁰ Ω
Spannungsfestigkeit	1000V _{RMS}
Test Voltage	1000V _{RMS}
Betriebsspannung	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Operating Voltage	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø 0,4 ... 0,56mm
oder Vierkantstift 0,25 x 0,45mm.
For round pin Ø 0,4 ... 0,56mm
or square pin 0,25 x 0,45mm.



Series	Contacts*	DIP-Spacing*	Terminal*	Sleeve Plating	Clip Plating*
174	24	3	10	50	30
174 IC-Fassung IC-Socket	06/08/10/12/14/16/ 18/ 20/22/24/28 20/22/24/28/32 10/24/28/32/36/ 40/42/48/50/52 50/52/64	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 L=6,0mm 20 L=8,0mm 30 L=10,2mm 40 L=12,0mm 50 L=15,0mm	50 Verzinkt Tin plated	10 0,25µm Gold 0,25µm gold plated 30 Vergoldet 0,75µm 0,75µm gold plated
Series	Contacts*	Rows*	Terminal*	Sleeve Plating	Clip Plating
187	24	2	10	50	10
187 IC-Leiste IC-Strip	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 L=6,0mm 20 L=8,0mm 30 L=10,2mm 40 L=12,0mm 50 L=15,0mm	50 Verzinkt Tin plated	10 Vergoldet 0,25µm 0,25µm gold plated

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:
Recommended Reflow-Soldering profile:

